(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月30日(30.05.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/109997 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/039376

(22) 国際出願日： 2024年11月6日(06.11.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2023-196508 2023年11月20日(20.11.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

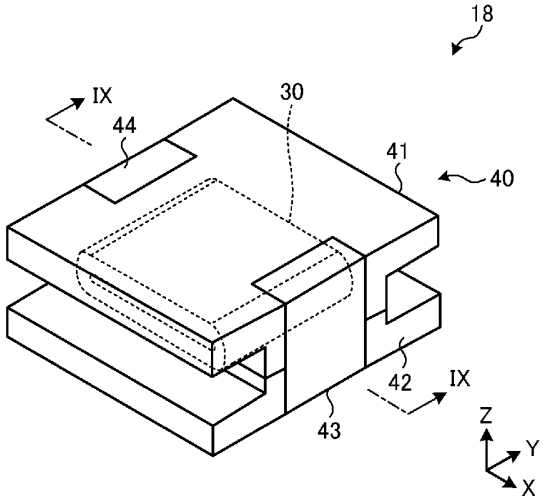
(72) 発明者: 梅 ▲ 崎 ▼ 翔 太 (**UMEZAKI, Shota**); 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 林田 貴大 (**HAYASHIDA, Takahiro**); 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP). 中島 幹雄(**NAKASHIMA, Mikio**); 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所 (**SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE**); 〒1000013 東京都千代田区霞が関３丁目８番１号 虎ノ門ダイビルイースト (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) **Title:** SUBSTRATE TREATMENT DEVICE, TREATMENT CONTAINER REPLACEMENT METHOD, SUBSTRATE TREATMENT METHOD, AND STORAGE MEDIUM

(54) 発明の名称： 基板処理装置、処理容器交換方法、基板処理方法および記憶媒体



(57) **Abstract:** A substrate treatment device (1) according to the present disclosure comprises: a treatment container (30); a supply line; a discharge line (34b); and a reinforcement member (40). The treatment container (30) has a treatment space (S) capable of accommodating a substrate (W), and the treatment space (S) is pressurized during the treatment of the substrate (W). The supply line supplies a treatment fluid into the treatment space (S). The discharge line (34b) discharges the treatment fluid in the treatment space (S). The reinforcement member (40) surrounds the outside of the treatment container (30) and is fixed integrally with the treatment container (30).

WO 2025/109997 A1

［続葉有］

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約:本開示による基板処理装置(１)は、処理容器(３０)と、供給ラインと、排出ライン(３４ｂ)と、補強部材(４０)とを備える。処理容器(３０)は、基板(W)を収容可能な処理空間(S)を有し、基板(W)の処理時において処理空間(S)が加圧される。供給ラインは、処理空間(S)内に処理流体を供給する。排出ライン(３４ｂ)は、処理空間(S)内の処理流体を排出する。補強部材(４０)は、処理容器(３０)の外側を囲み、処理容器(３０)と一体的に固定される。